



YMX18-2840C1

28 – 40 GHz 镜像抑制混频器

数据手册

四川益丰电子科技有限公司

Sichuan YiFeng Electronic Science & Technology Co., LTD

产品介绍

YMX18-2840C1 是一种 I/Q 镜像抑制混频器芯片，集成两个无源双平衡混频器和一个 90° 正交电桥，I/Q 两端口输出幅度一致、相位差 90° 的中频信号，通过在片外使用一个低频正交耦合器，即可实现镜像抑制功能。

应用领域

- GPS 系统
- 雷达
- 通信
- 仪表



关键技术指标

- RF和 LO范围：28GHz到40GHz
- IF范围：DC –6GHz
- 变频损耗：10dB
- 本振功率：17dBm
- LO/RF隔离度：35 dB
- 镜像抑制度：25dBc
- 芯片尺寸：1.35mmx0.9mmx0.1mm



YMX18-2840C1
数据手册

极限值

温度 =25 °C，除非有其它说明。

最大输入功率	+20dBm
存储温度	-65°C ~ +150°C
工作温度	-55°C ~ +125°C

电参数

温度=25 °C – 射频性能在片测试。

指标	最小值	典型值	最大值
RF&LO 频率 (GHz)	28~40		
IF 频率 (GHz)	DC~6		
变频损耗 (dB)	—	10	—
LO~RF 隔离度 (dB)	—	35	—
LO~IF 隔离度 (dB)	—	35	—
RF~IF 隔离度 (dB)	—	36	—

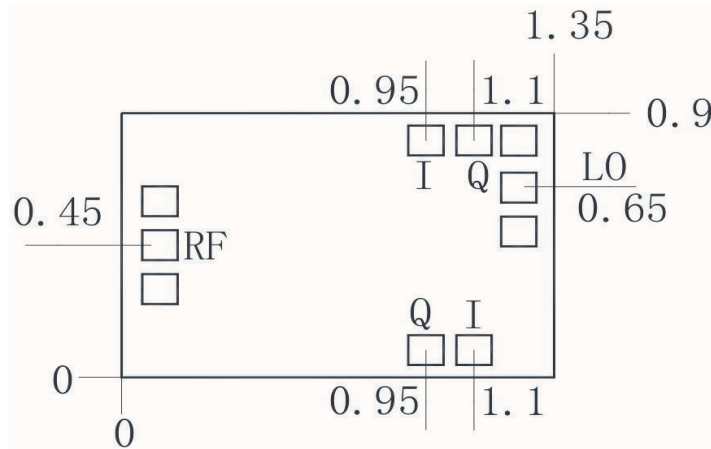


注意：本产品是高性能的射频器件，不当的操作会损害本产品。所有的操作必须符合标准的ESD保护标准。更多保护措施请查阅益丰公司文档“OM-CI-MV/ 001/ PG”。



YMX18-2840C1
数据手册

外形和端口尺寸 (mm)



注意事项

1. 芯片在干燥、氮气环境中存储，在超净环境使用；
2. GaAs 材料较脆，不能触碰芯片表面，使用时必须小心；
3. 芯片用导电胶或合金烧结（合金温度不能超过 300℃，时间不能超过 30 秒），使之充分接地；
4. 芯片微波端口与基片间隙不超过 0.05mm，使用 $\Phi 25 \mu m$ 双金丝键合，建议金丝长度 250~400 μm ；
5. 芯片输入输出端均无隔直电容；
6. 芯片对静电敏感，在储存和使用过程中注意防静电。



YMX18-2840C1 数据手册

定义

极限值定义

极限值是根据绝对最大额定值系统(IEC60134) 给出的。压力高于一个或多个极限值，会造成对该产品的永久性损坏。这些是压力额定值，并且以这些额定值或者其它任何高于规定额定值的条件去操作器件将得不到任何保证。长时间的极限值操作可能会影响产品的可靠性。

使用方法

在此描述的产品的使用方法仅起说明作用。在没有进一步测试或修正的情况下，益丰不作任何陈述或保证：这些使用方法将适用于特定用途。

免责声明

生命保障类应用

这些产品并非为生命保障应用、器件或系统而设计的，因此，这些产品的故障可能会导致人身伤害。

若益丰的客户在生命保障类应用中使用或销售这些产品，应自担风险，并同意全部赔偿此类应用给益丰公司造成的任何损失。

修改权限

益丰公司持有对产品做出修改的权利，恕不另行通知，修改包括对电路、标准单元或软件进行设计或性能修改。除非另有说明，益丰公司对这些产品的使用不承担任何责任或义务，不在任何专利、版权、或侵权下转让许可或权利，也不会做出任何陈述或保证：这些产品不受专利、版权或侵权限制。

文件历史记录：版本 2.0，最新更新 2021 年 3 月 03 日 星期三